한화, 2층 FCCL 사업에 300억원 투자

시장선점·국산화 요구 발맞춰 신규 투자 … 3층 FCCL 생산도 확대

한화종합화학(대표 추두련)이 2층 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate/동박적층필름) 사업에 300억원을 투자키로 했다고 6월1일 발표했다.

연성회로기판의 원판으로 휴대폰 등에 사용되는 FCCL은 현재 동박, 접착제, 폴리이미드 필름으로 구성되는 3층 형태가 주류를 이루고 있다.

한화종합화학은 현재 월 30만평방미터의 생산능력을 가지고 3층 FCCL을 생산하고 있으며 수요가 증가하고 있는 2층 FCCL 시장 선점을 위해 6월부터 300억원을 투자해 기존 생산시설을 증설하고 2층 FCCL 설비를 신규로 도입한다.

한화종합화학은 추가 신·증설로 2005년 말까지 2층 FCCL 월 8만평방미터, 3층 FCCL 월 60만평방미터의 생산능력을 갖추게 되며 3차 증설이 완료되는 2007년에는 2층 월 16만평방미터, 3층 월 90만평방미터를 생산해 한해 매출액 2000억원을 달성할 것으로 기대했다.

2층 FCCL은 3개층에서 접착제가 없는 구조로 고온 적용이 가능하고 미세패턴의 회로 제작이 가능해 하드디스크 광 Pick-Up, 휴대폰, 디지털 카메라 등 용도가 크게 증가하고 있다.

한화종합화학 관계자는 "2층 FCCL은 현재 일본과 타이완에서 전량 수입되고 있어 투자를 통해 공급이 부족한 전자부품 소재의 국산화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

<화학저널 2004/06/02>

Copyright ⓒ 2003 by CMRI 화학경제연구원